國立金門大學 電子工程學系碩士班 課程規劃表

本學系碩士生畢業時至少應修滿 30 學分,包括

基礎必修: <u>6</u>學分專業選修: <u>24</u>學分

111年3月30日110學年度第二學期第二次系課程規劃委員會通過/修訂通過 111年4月20日110學年度第二學期第一次院課程規劃委員會通過/修訂通過 中華民國111年0X月XX日1XX學年度第X學期第X次校級課程規畫委員會通過

		一年級	上馬	上學期 下學		ショシ シェア・ション シェア・ション シェア・ション かいし	二年級	上	:學期 -		嬰期	
			學分	時數	學分	時數		學分	時數	學分	時數	二年 合計
共同必修		校園學術倫理數位課程	0	1								
終言十			0		0			0		0		0
		專題討論(一)(三)(五)(七)						0	1			
專業必修		專題討論(二)(四)(六)(八)								0	1	
							學位論文			6		
總	計		0		0			0		6		6
	研究基 礎領域	科學計算	3	3			校外實習(一)	0	1			
							校外實習(二)			0	1	
		數位影像處理	3	3			展頻通訊	3	3			
		鎖相迴路設計與應用	3	3			高等計算機結構	3	3			
		數位信號處理			3		嵌入式行動機器人	3	3			
	\ 	行動通訊系統			3	3						
		編碼理論			3	3						
		模糊系統			3	3						
	用領域	智慧型計算			3	3						
		電力電子實務			3	3						
		太陽能電力系統			3	3						
專業選		新能源技術	3	3			表面分析技術	3	3			
修		再生能源薄膜工程	3	3			奈米工程	3	3	3	3	
		作工能源為 能量轉換原理	3	3			<u> </u>			3	3	
		射頻積體電路與模擬	3	3								
		模式化通訊IC設計	3	3								
		半導體元件及物理	3	3								
	固態與	超大型積體電路設計			3	3						
		表面工程			3	3						
		半導體量測技術			3	3						
		太陽能技術			3	3						
		通訊網路積體電路設計			3	3						
		高頻電路佈局與模擬			3	3						
		類比積體電路設計與模擬			3	3						
		半導體製程技術			3	3						
Lafes N. L			0.7		4 =			10				07
總計			27		45			12		3		87
學期總計			27		45			12		9		

備註:

- 一、畢業總學分30學分,學位論文6學分,專業選修24學分,必須滿足本學系修讀規定。
- 二、「專題討論(一)~(八)」為在其修業期間每學期必修0學分1小時之課程。
- 三、專業選修課程不分年級。
- 四、碩班課程皆與學士班四年級合開。
- 五、表列選修科目為預定科目,將視實際需要而調整。
- 六、專題討論(一)及(二)以指導教授參與的專長組別為主。
- 七、「專題討論(五)~(八)」得抵修任一學期「專題討論(一)~(四)」